

**LITERATURVERZEICHNIS**

In diesem Kapitel wird neben der im Leitfaden zitierten sowohl die von den Autoren dieses Leitfadens als auch andere in den letzten Jahren veröffentlichte relevante weiterführende Literatur aufgeführt.

[Amb91]	S. Amberg-Schwab, E. Arpac, W. Glaubitt, K. Rose, G. Schottner und U. Schubert, <i>Materials Science Monographs – High Performance Ceramic Films and Coatings</i> , Vol. 67 (Ed: P. Vincencini), Elsevier, Amsterdam (1991), p. 203.
[Aßf04]	C. Aßfalg, „ <i>Reinigung und Bleifrei: Neuester Stand</i> “, Productronic, Heft 5-6 (2004) 22-24.
[Asy06]	Seminar-CD zu Asymtek-Technology Days Juni 2006 mit Beiträgen von E. Vanlathem (Dow Corning), I. Sheiham (Beck), J. Mycke (Asymtek), M. Kaing (HumiSeal), S. Schröder (Peters), A. Hilton (Emerson&Cuming), I. Wilding, (Henkel), K.-F. Becker (IZM) und R. Tijburg (Philips).
[Bag88]	E. Bagda, „ <i>Zum Feuchtehaushalt von Beschichtungen</i> “, farbe + lack 94 (1988) 8, 606-609.
[Bar94]	T.A. Barbari, R.M. Conforti, „ <i>Recent theories of gas sorption in polymers</i> “ <i>Polymers for Advanced Technologies</i> , 5 (1994) 698-707.
[Bei06]	H. Beine, „ <i>Automatisch Dispensen a la Carte</i> “, Productronic, Heft 1/2 (2006) 2-3.
[Bün04]	K. Bünning, „ <i>Aspekte zur Erhöhung der Temperaturwechselbeständigkeit von Leiterplatten</i> “, PLUS, 10, (2004).
[Buc05]	J. Buch, „ <i>Flexibilität ist Trumpf – Schutzbeschichtung von elektronischen Baugruppen</i> “, Teil 1: Productronic, Heft 04 (2005), Teil 2: Productronic, Heft 08/09 (2005), Teil 3: Productronic, Heft 10 (2005).
[Bus04]	I. Buschke, „ <i>Neue Erkenntnisse bei der Nutzung innovativer UV-aushärtender Lacke zum Schutz von Elektronik in der industriellen Produktion</i> “, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 295-301.
[Cha03]	T. Charlton, „ <i>Conformal Coatings Made Easy</i> “, Circuits Assembly, Heft 10 (2003) 2-5.
[Con03]	„ <i>Facts &amp; data book – Conformal Coating – Selection and Application</i> “, Concoat Ltd., (2003).
[Dep00]	L. Depré, M. Ingram, Ch. Poinson und M. Popall, <i>Electrochim. Acta</i> 45 (2000) 1377.
[Dra07]	H.-G. Drape, „ <i>Parylene als Oberflächenschutz</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Ehr99]	G.W. Ehrenstein, „ <i>Polymer-Werkstoffe</i> “, Hanser-Verlag, (1999).
[Ein04]	„ <i>Einflussgrößen und Lösungswege aus der Sicht der Leiterplattenhersteller</i> “, VdL, ZVEI – Panel Discussion, „Erhöhte Anforderungen an die Zyklenfähigkeit von elektronischen Baugruppen“, SMT 2004.
[Ell89]	B.N. Ellis, „ <i>Reinigen in der Elektronik</i> “, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (1989).
[EriXX]	S. Erickson „ <i>Präzise Beschichtungstechniken für Conformal Coating Anwendungen</i> “ unter <a href="http://www.gps-technologies.com">www.gps-technologies.com</a>
[Fre99]	J. Freund, J. Halbritter, J.K.H. Körber, „ <i>How dry are Dried Samples? Water Adsorption Measured by STM</i> “, <i>Microscopy Research and Technique</i> 44 (1999) 327-338.
[Frö02]	L. Fröhlich, R. Houbertz, S. Jacob, M. Popall, R. Mueller-Fliedler, J. Graf, M. Munk und H. von Zychlinski, <i>Mater. Res. Soc. Symp. Proc.</i> , 726 (2002) 349.
[Fun89]	W. Funke, E. Fischer, „ <i>Haftfestigkeit organischer Beschichtungen auf Metallen bei Einwirkung von Wasser</i> “, farbe + lack 95 (1989) 6, 403-407.
[Gil07]	B. Gillespie, M. DeBenedetto, „ <i>Conformal Coating and Board Cleanliness</i> “, Circuits Assembly, unter <a href="http://www.circuitsassembly.com">www.circuitsassembly.com</a> am 01.02.2007.
[Hab97]	G. Habenicht, „ <i>Kleben</i> “, Springer-Verlag, (1997).
[Haa00]	K.-H. Haas, <i>Advanced Engineering Materials</i> , 2 (2000) 571.

[Hoc02]	„Hochtemperaturelektronik – Stand und Herausforderungen“, VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM), (2002).
[Hou01]	R. Houbertz, J. Schulz und M. Popall, <i>Mater. Res. Soc. Symp. Proc.</i> <b>665</b> (2001) 321.
[Hou03]	R. Houbertz, G. Domann, J. Schulz und M. Popall, <i>Mater. Res. Soc. Symp. Proc.</i> <b>769</b> (2003) 239.
[Hou04]	R. Houbertz, <i>Appl. Surf. Sci.</i> , 247 (2004) 504-512.
[Gho94]	K. Ghosal, B.D. Freeman, „Gas Separation Using Polymer Membranes: An Overview“, <i>Polymers for Advanced Technologies</i> , 5 (1994) 673-697.
[Gub04]	F. Gubbels, M. Onishi, „Controlled volatility silicon conformal coatings: why and how to use them“, <i>Global SMT &amp; Packaging</i> , 10-14 (2004).
[Gub05]	F. Gubbels, M. Onishi, M. Stephan; „Ausgasungen aus Siliconen“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[HdT07]	Tagungsunterlagen Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“, 22. März 2007; Haus der Technik, Essen.
[Jil03]	W. Jillek, G. Keller, „Handbuch der Leiterplattentechnik“, Band 4, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (2003).
[Kai92]	W.-D. Kaiser, S. Pietsch, A. Rudolf, „Zusammenhänge zwischen Permeations- und Adhäsionsverhalten sowie der Unterrostung organischer Beschichtungen“, <i>farbe + lack</i> 98 (1992) 3, 182-187.
[Kin06]	P. Kinner, „Maximieren Sie Ihr Investment: Prüfen Sie auf bleifrei und lösungsmittelfrei“, <i>SMT</i> 8-9 (2006) 14-16.
[Kli01]	W. Klingel, „Die Zukunft der Schutzbeschichtung“, <i>Productronic</i> , Heft 03 (2001).
[Kli03]	W. Klingel, „Schutzbeschichtung als Dienstleistung“, <i>VTE</i> , Heft 15 (2003) und <i>Productronic</i> , Heft 06 (2003).
[Kli04]	W. Klingel, „Lackierpraxis heute“, in: DVS/GMM (Hrsg.), <i>GMM-Fachbericht</i> , Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 313-316.
[Kli05a]	W. Klingel, „Vergusstechniken für den Schutz von Flachbaugruppen“, <i>PLUS</i> , Heft 5, (2005) 893-901.
[Kli05b]	W. Klingel, „Fehlerbilder beim Schutzlackieren“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Kli05c]	J.-H. Klingel, „Nässe, Säure, Schmutz & Co. – Sichre Funktion durch Verguss“, <i>Productronic</i> , Heft 5-6 (2005) S. 30-31.
[Kli05d]	J.-H. Klingel, „Fehlerbilder beim Schutzlackieren – Vorbeugende Maßnahmen beim Lackieren“, <i>EPP</i> , Heft 11-12 (2005) S. 59.
[Kli05e]	J.-H. Klingel, „Im Sekundentakt – Selektive Schutzbeschichtung und Trocknung“, <i>Productronic</i> , Heft 11 (2005) S. 81.
[Kli06a]	J.-H. Klingel, „Klimaausfälle sind vermeidbar“, <i>Productronic</i> , Heft 05 (2006) S. 64-65.
[Kli06b]	J.-H. Klingel, „Verlaufsstörungen“, <i>Technische Information der Fa. Kunststoff-Chemische Produkte GmbH, Frieolzheim</i> , (2006).
[Kli07a]	J.-H. Klingel, „Klimaausfälle sind vermeidbar – Schutzlackierung als Dienstleistung“, <i>EPP</i> , Heft 01/02 (2007) S. 34.
[Kli07b]	J.-H. Klingel, „Schutzlackierung – Problemstellung und Lösungen aus der Praxis“, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.
[Knö89]	P.A. Knödel, „Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten“, <i>Metalloberfläche</i> , Heft 04-05 (1989).
[Knö03]	P.A. Knödel, „Partielle Beschichtung nichttauchfähiger Baugruppen“, <i>Productronic</i> , Heft 11 (2003).

[Knö04]	P.A. Knödel, „Schutzlackierung von Elektronik-Baugruppen bei großen Durchsätzen“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 309-312.
[Knö05]	P.A. Knödel, „Große Durchsätze ohne Probleme“, productronic, Heft 11 (2005).
[Knö06]	P.A. Knödel, „Elektronikbaugruppen tauchlackieren mit Silikon-Schutzlack“, LPinfos, 40 (2006) 15-17.
[Lei07]	H. Leiner, „Die Schutzlackierung und Rückstände aus dem Lötprozess“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Län07]	M. Länzsch, „Wie gefährlich sind Flussmittelrückstände? – Normen, Vorschriften, Grundlagen“, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.
[Lie01]	J. Lienemann, „Testverfahren, Qualifikation und EMV“, IMTEK, Lehrstuhl für Simulation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, (2001).
[Luc73]	W.A.P. Luck, „Structure of Water and Aqueous Solutions“, Verlag Chemie, Weinheim (1973).
[Mar07]	C. Mark, „Teflondispersionen zum Schutz elektronischer Baugruppen“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Mue07]	M. Müller, „Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethan- Verarbeitungsfehler und deren Vermeidung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Neh05]	F. Nehmeier, „Feuchtigkeit und Schutzlackierung in der Kfz-Elektronik“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Nev04]	B. Neves, „Accelerating PTH Reliability Testing while reducing Cost“, EIPC - Summer Conference 2004, Basel.
[Nol68]	W. Noll, „Chemistry and Technology of silicones“, Academic Press (1968).
[Ott05a]; [Ott06a]; [Ott07a]	Tagungsband (CD) OTTI-Profiforum „Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik“, 16./17. März 2005. 06./07. November 2006 und 20./21. Juni 2007; OTTI-Kolleg.
[Ott06b]	Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „Produktion bleifreier elektronischer Baugruppen“, 05./06. April 2006; OTTI-Kolleg
[Ott07c]	Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, 14./15. März 2007; OTTI-Kolleg
[Pap06]	U. Pape, M. Rittner, T. Liebl, N. Neher, M. Nowotnick, „Untersuchung der Zuverlässigkeit hochtemperaturgeeigneter Baugruppen“, GMM-DVS-Tagung, Fellbach, (2006).
[Pie92]	M. Piepho, „Sicherheitsaspekte bei der Gießharzverarbeitung“, Elektrizitätswirtschaft, 91 (1992) 1760.
[Pie94]	M. Piepho, „Vergleich der Eigenschaften unterschiedlicher Kaltverguss-Systeme für elektrische Anwendungen (Energiebilanzen synthetischer und teilsynthetischer Vergussmassen)“, Elektrizitätswirtschaft, 93 (1994) 1682.
[Pie95]	M. Piepho, „Vergleich von Vergussmassen“, ETZ, 116, Heft 23-24 (1995) 22.
[Pie97]	M. Piepho, „Füllstoffe in Elektroisierstoffen“, ETZ, 118, Heft 6 (1997) 56.
[Pie03]	M. Piepho, „Unverzichtbar: Vergussmassen für Elektrotechnik und Elektronik“, PU-Magazin, Heft 4 (2003).
[Pie06a]	M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen“, etz, Heft 7 (2006) 44-47.
[Pie06b]	M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen“, PU-Magazin, Heft Juni/Juli (2006) 125-130.
[Pie07a]	M. Piepho, „Vergussmassen, PUR, Epoxid, Silikon, Kohlenwasserstoffharze“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Pol85]	Polymer Permeability, J. Comyn (ed.), Elsevier Applied Science, London (1985).

[Pop92]	M. Popall, J. Kappel, M. Pilz und J. Schulz, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. <b>264</b> (1992) 353.
[Pop98]	M. Popall, M. Andrei, J. Kappel, J. Kron, K. Olma und B. Olsowski, Electrochim. Acta <b>43</b> (1998) 1155.
[Plu82]	E.P. Plueddeman, „ <i>Silicone coupling agents</i> “, Plenum Press, New York, (1982).
[Rob98]	M.E. Robertsson, O.J. Hagel, G. Gustafsson, A. Dabek, M. Popall, L. Cergel, P. Wennekers, P. Kiely, M. Lebyy und T. Lindhal, Proc. 48 <sup>th</sup> Electron. Comp. Technol. Conf. (Seattle, Washington, USA), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 1998 IEEE Catalogue No. 98CH36206 (1998), p. 1413.
[Roc87]	E.G. Rochow, „ <i>Silicon and Silicones</i> “, Springer-Verlag, Heidelberg, (1987).
[Ros95]	K. Rose, in: <i>Organosilicon Chemistry II</i> , N. Auner, and J. Weis (eds.), VCH Weinheim, Germany (1995), p. 649.
[Sche07]	W. Scheible, „ <i>Rechtliche Aspekte bei der Schutzbeschichtung elektronischer Baugruppen - Haftung</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[SchlXX]	D. Schleiferböck, „ <i>Optimierung der Baugruppenlackierung</i> “, Firmenschrift Fa. Endress + Hauser GmbH & Co. KG.
[Schm96]	K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Klimabedingte Ausfälle elektronischer Baugruppen: Prüfbarkeit und Schutzstrategien</i> “, 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal (1996) - Tagungsband, Karlsruhe: DWS Werbeagentur und Verlag, (1996), S. 14-1 bis 14-15.
[Schm97]	K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Wirksamkeit von Elektronik-Schutzlacksystemen gegen elektrochemische Migration und Kriechstrombrücken</i> “, in: Thomann (Hrsg.): Werkstoffe für die Informationstechnik. Frankfurt: DGM-Informationsgesellschaft, (1997) 151-155.
[Schm07]	W. Schmitt, „ <i>Eigenschaften von Lotrückständen und ihr Einfluss auf die Schutzlackierung</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Schu98]	G. Schulze, „ <i>Selektives Schutzlackieren von Baugruppen</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (1998).
[Schu99]	G. Schulze, „ <i>Selektive und automatische Schutzbeschichtung von elektronischen Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 07/08 (1999).
[Schu00]	G. Schulze, „ <i>Überragende Prozesskontrolle durch geschlossene Regelkreise</i> “, LP infos, Heft 11 (2000).
[Schu01a]	G. Schulze, „ <i>Berührungsloses Jet Dispensen in der Praxis</i> “, Productronic, Heft 03 (2001).
[Schu01b]	G. Schulze, „ <i>Automatische, selektive Beschichtung mit Dickschichtlacken</i> “, LP infos, Heft 04 (2001).
[Schu02a]	G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „Beschichtung elektronischer Baugruppen“ Februar 2002, Frankfurt/M., Tagungsband.
[Schu02b]	G. Schulze, M. Reighard, „ <i>Automatisch Schutzbeschichten</i> “, Teil 1: Productronic Heft 05 (2002) 28; Teil 2: Productronic Heft 06 (2002) 48; Teil 3: Productronic Heft 07/08 (2002) 24.
[Schu03]	G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „Beschichtung elektronischer Baugruppen“ März 2003, Berlin, Tagungsband.
[Schu04]	G. Schulze, „ <i>Aktuelle Technologien für die automatische und selektive Beschichtung von bestückten Flachbaugruppen</i> “, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 303-308.
[Schu05a]	G. Schulze, „ <i>Prozessregelung bei automatisierten und selektiven Beschichtungsverfahren</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Schu05b]	G. Schulze, „ <i>Mehr Zuverlässigkeit durch Schutzlackierung</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2005).

[Schu05c]	G. Schulze, „Kontaktloses Dispensjet Verfahren“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2005).
[Schu05d]	G. Schulze, „Prozessregelung bei automatischen Beschichtungsverfahren“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2005).
[Schu06]	G. Schulze, „Beschichtung mit Prozessregelung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2006).
[Schu07a]	G. Schulze, „Performance im Detail“, Productronic, Heft 01-02 (2007) 21-22.
[Schu07b]	G. Schulze, „Automatische Dosierung und Beschichtung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Schw97a]	H. Schweigart, „Funktionssicherheit schutzlackierter elektronischer Baugruppen bei Feuchtklimabeanspruchung“, München, Hieronymus-Verlag, 1. Auflage (1997), 2. Auflage (1998).
[Schw97b]	H. Schweigart, S. Wege, „Prüfung von Lötstoppmasken und Schutzlacken mittels thermischer Analyse“ (SMT ES&S Hybrid, Nürnberg 1997) - Tagungsband, Berlin: VDE-Verlag, 1997, S. 175-183.
[Schw98]	H. Schweigart, „Einfluss der Umgebungsbedingungen auf die Schutzwirkung von Elektronikschutzlacken“, 27. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1998), Tagungsband.
[Schw99a]	H. Schweigart, „Ausfälle im Feld: teuer und vermeidbar?“, Productronic, Heft 10 (1999).
[Schw99b]	H. Schweigart, „Die Schaden- und Schwachstellenanalyse als Instrument des Testtailoring für die Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, 28. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1999) Tagungsband.
[Schw00]	H. Schweigart, E. Christian, „Plus für hohe Zuverlässigkeit – Nachweis von Flussmittelrückstand und Aktivator auf Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2000).
[Schw01a]	H. Schweigart, „No clean und bleifrei: ein Widerspruch?“, Productronic, Heft 10 (2001) 1-2.
[Schw01b]	H. Schweigart, „Fehlursachen klimatisch beanspruchter Elektronikschaltungen“, SMT, Heft 04 (2001) 18-20.
[Schw03a]	H. Schweigart, S. Repp; „Oberflächenreinheit bei Bond- und Coating Prozessen“, JOT, Heft 11 (2003) 36-38.
[Schw03b]	H. Schweigart, S. Strixner, A. Mühlbauer; „Optimal Reinigen unter BGAs?“, Productronic, Heft 12 (2003).
[Schw03c]	S. Repp, H. Schweigart, „Zuverlässigkeit steigern – Reinigen in der Elektronikfertigung“, Metalloberfläche, Heft 11 (2003) 35-38.
[Schw03d]	H. Schweigart, „Brauchen Coatings Reinigungß“, VTE Verbindungstechnik in der Elektronik, 15, Heft 01 (2003) 20-24.
[Schw04]	H. Schweigart, „Reinheitsanforderungen und Reinigung vor der Beschichtung“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 321-325.
[Schw05]	H. Schweigart, „Oberflächencharakterisierung vor der Beschichtung“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Schw06a]	H. Schweigart, S. Strixner, „Coatings schnell und kostengünstig prüfen – Testmethode zur Überprüfung von Schutzlackierungen elektronischer Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 5-6 (2006) 96-97.
[Schw06b]	H. Schweigart, „Wenn der Lack abgeht – Mindestreinheit der Oberfläche vor der Schutzbeschichtung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 10 (2006) 30-32.
[Schw07a]	H. Schweigart, D. Borgend, „Bauelemente-Vorbehandlung durch Reinigung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Sei07]	A. Seiwert, T. Lauer, „Der Vorteil eines modernen Reinigungsprozesses“, SMT, Heft 6-7 (2007) 19-20.
[Sil89]	„Silicone: Chemie und Technologie“, Vulkan-Verlag, Essen, (1989).

[Sil01]	„Übersicht über die Silicon-Chemie“, Firmenschrift der Fa. Dow Corning Corp., (2001); veröffentlicht in erster Version von A. Colas unter dem Titel „La chimie des silicones“ in Chimie Nouvelle, Vol. 8 (30) (1990) 847.
[Ste07]	M. Stephan, „Silicones for Automotive Electronics Applications: Advances in Adhesives and Thermal Materials“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Str02]	U. Streppel, P. Dannberg, Ch. Wächter, A. Bräuer, L. Fröhlich, R. Houbertz und M. Popall, Opt. Mater. 21 (2002) 475.
[Str07]	S. Strixner, „In einem einzigen Prozess reinigen? – Bleifreie und bleihaltige Baugruppen“, productronic, Heft 3 (2007) 28-31
[Sup00]	M. Suppa, „Der Einsatz von Vergussmassen in der Elektronik“, Teil 1: PLUS, Heft 03 (2000), Teil 2: PLUS, Heft 06 (2000), Teil 3: PLUS, Heft 08 (2000).
[Sup01a]	M. Suppa, M. Kollasa „Dickschicht-Beschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – ein Widerspruch?“, PLUS, Heft 08 (2001) und Ref.-Nr. 152 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2001).
[Sup01b]	M. Suppa, „Dickschichtbeschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – Dick aufgetragen, schnell getrocknet“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 04 (2001).
[Sup02]	M. Suppa, „Conformal coatings for Component Protection“, Circuits Assembly, Vol. 13, Heft 06 (2002).
[Sup03]	M. Suppa, „Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen“, VTE Aufbau- und Verbindungstechnik, Heft 01 (2003).
[Sup04a]	M. Suppa, „Die Schutzlackierung von elektronischen Baugruppen – von High-Solid-Lacken über wasserverdünnbare hin zu lösemittelfreien Schutzlacken“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 287-294 bzw. als Ref.-Nr. 159 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04b]	M. Suppa, „Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima- und Kriechstromzuverlässigkeit“, Ref.-Nr. 160 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04c]	M. Suppa, „Ökologische Technologien und Beschichtungsstoffe für Leiterplatten“, Ref.-Nr. 155 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04c]	M. Suppa, „Zuverlässigkeitsprüfungen und Ausfallmechanismen bei Lötstopplacken“, VdL, ZVEI – Panel Discussion, „Erhöhte Anforderungen an die Zyklenfähigkeit von elektronischen Baugruppen“, SMT 2004.
[Sup04d]	M. Suppa, „Temperaturstress – Auswirkungen auf Schutzlacke in der Elektronik“, Metalloberfläche, Heft 11 (2004) 35-38.
[Sup04e]	M. Suppa, „Der komplette Lifecycle ist entscheidend – Beschichtungsmaterialien für Leiterplatten aus ökologischer Sicht“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2004).
[Sup05a]	R. Dietrich, P. Heuser, W. Peters, M. Suppa, „Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen“, Ref.-Nr. 150 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005).
[Sup05b]	M. Suppa, „Thermische Beständigkeit von Schutzlacken“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Sup05c]	M. Suppa, „Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik“, PLUS, Heft 9, (2005) 1609-1615.
[Sup05d]	M. Suppa, „Temperaturstress und Temperaturwechseltests – Auswirkung auf Schutz- und Lötstopplacksysteme“, Ref.-Nr. 161 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005).
[Sup06a]	M. Suppa, „RoHS, ELV und WEEE und ihre Auswirkungen auf die Beschichtungsstoffe für die elektronische Industrie“, Ref.-Nr. 162 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006).
[Sup06b]	M. Suppa, „Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik“, Ref.-Nr. 163 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006).

[Sup06c]	M. Suppa, „Zuverlässigkeit von fotostrukturierbaren Lötstopplacken für elektronische Baugruppen bei Belastung durch Temperaturdauerstress und Temperaturwechselstress“, DVS/DMM-Tagung, Fellbach, (2006) und PLUS, Heft 4, (2006) 659-666.
[Sup06d]	M. Suppa, „Temperaturresistente Schutzlacke“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Teil 1: Heft 1/2 (2006); Heft 4 (2006).
[Sup06e]	M. Suppa, „Schnellste Prozessierung von Schutzlacken mit der UV-Technologie“, PLUS, Heft 6, (2006) 870-876.
[Sup06f]	M. Suppa, „Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen bei Belastung durch hohe Temperaturen und hohe Feuchte“, LPinfos, 40 (2006) 4-6.
[Sup06g]	M. Suppa, „The reliability of photoimageable solder resists“, Circuitree, (2006).
[Sup07a]	M. Suppa, „Schutzlacke zur Verbesserung der Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.
[Tau91]	C.J. Tautscher, „Contamination Effects on electronic products“ New York: M. Dekker, Inc., (1991).
[Tut04]	Unterlagen zum Tutorial 25 „Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima und Kriechstromzuverlässigkeit“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 15. bis 17.06.2004.
[Tut06]	Unterlagen zum Tutorial 24 „Die Schutzbeschichtung und ihre steigende Bedeutung für den sicheren Betrieb von elektrischen Baugruppen“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 30.05. bis 01.06.2006.
[Uhl95]	S. Uhlig, L. Fröhlich, M. Chen, N. Arndt-Staufenbiel, G. Lang, H. Schröder, R. Houbertz, M. Popall und M. Robertsson, IEEE Trans. Adv. Packaging, Part B, 29 (2006) 158-170.
[Vin84]	C.R. Vincentz, „Glasurit-Handbuch Lacke und Farben“, Vincentz-Verlag Hannover, 11. Auflage, (1984).
[Weg00]	S. Wege, „Korrosionserscheinungen auf elektronischen Baugruppen unter Klimabeanspruchung“, Materials and Corrosion, 51, Heft 1 (2000) 7-12.
[Wol94]	H. Wolter, W. Storch und H. Ott, Mater. Res. Soc. Proc. 346 (1994) 143.
[Zas04]	H. Zastrow, K.-W. Lienert, G. Schmidt, „Lösemittelfreie Beschichtungen“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 317-320.
[Zas05]	H. Zastrow, „Lösemittelfreie Beschichtung“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Zor98]	U. Zorll, „Lacke und Druckfarben“, Römpf-Lexikon, Georg Thieme Verlag (1998).

Außerdem werden in folgenden Firmenschriften regelmäßig Artikel zur Thematik der Anwendung und Erzeugung von Schutzbeschichtungen für elektronische Baugruppen veröffentlicht:

- **LPinfos** (Kundenzeitschrift der Fa. Lackwerke Peters GmbH + Co. KG; [www.peters.de](http://www.peters.de); erscheint zweimal pro Jahr)
- **ZESTRON news** (Kundeninformation Fa. zestron; [www.zestron.com](http://www.zestron.com); erscheint dreimal pro Jahr)